

熱対策セミナー part4

～小型チップ部品の温度コントロール術～

※熱対策セミナーとして4回目の開催ですが、今回からの視聴でもご理解いただける内容となっております。

講師：KOA株式会社

【開催日】2022年8月25日(木)

【時間】

10:15～12:00 (9:45～ 接続可能)

【コンテンツ】

- 1.部品の小型化・高熱流束化と熱問題
- 2.基板放熱の重要性と設計指針
- 3.基板放熱対策と熱抵抗の概要
- 4.基板一筐体放熱の事例

※ 内容は一部変更になる可能性があります。
※ セミナー終了後、アンケートのご協力をお願い申し上げます。

【参加費】

無料(セミナー定員500名)

【接続方法】

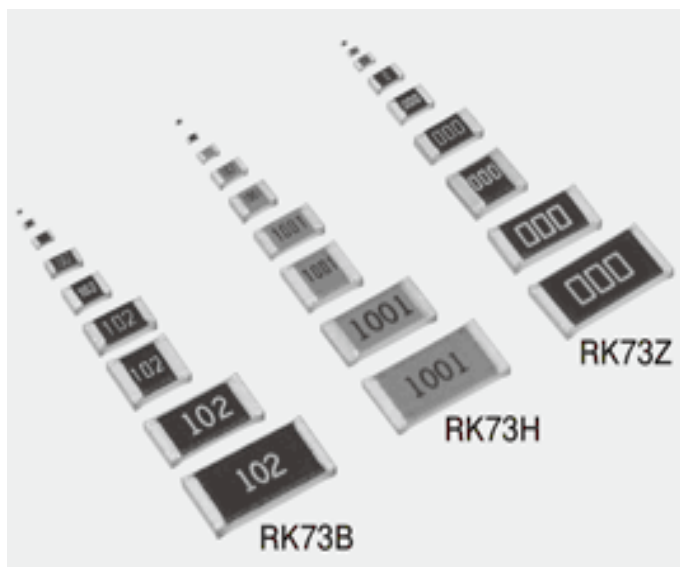
Zoomウェビナー

【必要なもの】

- インターネット環境(下りスピード1Mbps以上推奨)
- PC、タブレットの端末
- イヤホン、スピーカ(任意)
- 弊社からの招待メール

【受講までの流れ】

- 1.専用サイトからお申し込みを頂きます。(「東海電気電子 技術セミナー」で検索して下さい)
- 2.開講3日前に送られる招待メールを受領し、メールに記載されたURLにアクセスします。
- 3.「ブラウザから参加」をクリックします。(アプリ版からのご参加も可能です)
- 4.参加者の登録を行い「参加」をクリックします。(カメラ/マイクは自動でミュートされます)
- 5.「コンピュータからオーディオに参加」をクリックするとセミナーの表示となります。



主催・お問い合わせ

東亜エレクトロニクス株式会社 ハマトウカンパニー

営業推進担当：大石・太田

〒431-2102 静岡県浜松市北区都田町9162-1

TEL：053-428-1121 FAX：053-428-1131

E-mail：seminar@toukai-denkidenshi-sekkei.com

Web：http://toukai-denkidenshi-sekkei.com/

【次回開催予告】

第72回 2022年11月17日(木)

熱対策セミナーpart5

～小型チップ部品のための基板放熱設計～

講師：KOA株式会社

※開催日、セミナー内容は変更される可能性があります。